

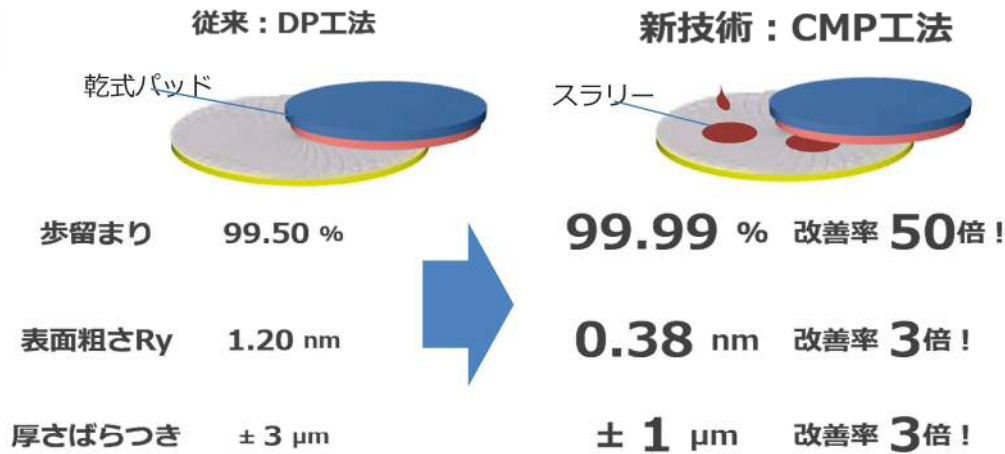
ひとわざ(一技)名: 半導体シリコンウェハの鏡面仕上げ

1. 概要(200字目安)

半導体のシリコンウェハを鏡面仕上げすることで、ICチップを割れにくく、折れにくくすることが可能です。現在まで、ドライポリッシュ加工にて鏡面仕上げをしていましたが、CMP加工も導入いたします。(Chemical Mechanical Polish)

歩留まり、面粗さ、厚さばらつきが、劇的に改善されます。また、品質向上により、品質要求の厳しい車載向けにも使用可能です。

写真・図(要点説明)



品質向上により、車載向けでも対応可能!

2. 企業概況

|          |                         |         |               |
|----------|-------------------------|---------|---------------|
| フリガナ     | カシキガイシャ ニチワコウギョウ        | フリガナ    | テラサワ シゲル      |
| 会社名      | 株式会社 ニチワ工業              | 代表者名    | 寺澤 茂          |
|          |                         | フリガナ    | サウ ツム         |
| 事業内容     | 半導体、難切削材の研削、切削加工        | 窓口担当    | 佐藤 努          |
| 主要製品     | 精密研削・切削加工、情報画像サプライ品の製造  |         |               |
| フリガナ     | カシキガイシャ ニチワコウギョウ        |         |               |
| 住所       | 〒391-0003 長野県茅野市本町東3-17 |         |               |
| 電話/FAX   | 0266-72-6840            | E-mail  | HPから問い合わせください |
| 資本金(百万円) | 15                      | 設立年月    | 1970年3月       |
|          |                         | 売上(百万円) | -             |
|          |                         | 従業員数    | 125           |

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

- ①・ISO9001:2015年度版取得済み  
・ISO14001:2015年度版取得済み
- ②半導体用の高精度設備を多数そろえておりますので、上記加工だけでなく、ダイシング、各種トレー詰め、仕様に応じた梱包状態で出荷が可能です。また、超純水製造設備を所有しておりますので、洗浄作業等も可能です。